

ニュースガイドNo, 10891

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載!

## 無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成25年(1年間) 70点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,600-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,600-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥32,400-	¥30,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10830	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19	66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,9997A	"	"	平.15	62点	¥18,300
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-平.9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-平.11	75点	¥29,700
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	68点	¥24,700

\*お申し込み方法...下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com))

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所: 〒		

料金には別途送料がかかります。

# 無電解貴金属メッキ方法と工程

No.10891

[公開編] 平成25年(1年間) 70点

CD-ROM版 ¥21,600 B5製本版 ¥21,600 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥32,400 )

- |  |                                       |    |   |                                       |
|--|---------------------------------------|----|---|---------------------------------------|
| 有機ケイ素化合物および該有機ケイ素化合物を使用する無電解めっきの前処理方法                                    | 株式会社ADEKA                             | 30 | フィルタ材およびフィルタ材の製造方法                                | 日立電線株式会社                              |
| 2 無電解めっき用塗料組成物   | 株式会社イオックス                             | 31 | プラスチック金属化立体配線の製造方法                                | 胡 泉凌                                  |
| 3 固体高分子電解質膜・触媒金属複合電極及びその製造方法   | 三菱電機株式会社                              | 32 | めっき積層体の製造方法                                       | 出光興産株式会社                              |
| 4 導電性粒子の製造方法   | 日本化学工業株式会社                            | 33 | 被覆体及び電子部品   | TDK株式会社                               |
| 5 回路用導電フィルム  | アキレス株式会社                              | 34 | 被覆体及び電子部品   | TDK株式会社                               |
| 6 線状導体及び該線状導体の製造方法   | 並木精密宝石株式会社                            | 35 | 無電解めっき前処理剤及び該前処理剤を用いた無電解めっき前処理方法                  | 株式会社ADEKA                             |
| 7 プリント回路基板の無電解表面処理めっき層及びその製造方法   | サムソン エレクトロ・メカニクス カンパニーLtd.            | 36 | 無電解めっき前処理剤及び該前処理剤を用いた無電解めっき前処理方法                  | 株式会社ADEKA                             |
| 8 配線基板のめっき方法、めっき配線基板の製造方法、及び銀エッチング液イミダゾール環結晶型オキシアルキレン化合物及び当該化合物を含有するメッキ浴 | 株式会社トクヤマ                              | 37 | 無電解メッキ用シート状物及びこれにメッキ被膜を形成した被メッキ物                  | 株式会社イオックス                             |
| 9 無電解複合めっき液用分散剤  | 石原薬品株式会社                              | 38 | 配線基板  | 京セラS L Cテクノロジー株式会社                    |
| 10 無電解複合めっき液用分散剤   | 日華化学株式会社                              | 39 | 貴金属保護膜  | 株式会社ジュエリー・ミウラ                         |
| 11 金属膜付きガラス材料および製造方法   | 学校法人関東学院                              | 40 | 安定化された銀触媒および方法                                    | ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー               |
| 12 置換めっきを用いたダイヤモンド付着方法及びこれに用いられるダイヤモンド付着装置                               | イファ・ダイヤモンド・インダストリー・カンパニー・リミテッド        | 41 | めっき触媒および方法  | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー |
| 13 無電解金属化のための安定な触媒   | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー | 42 | 複合材料  | 独立行政法人科学技術振興機構                        |
| 14 無電解金属化のための安定な触媒   | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー | 43 | アルミニウム構造体、その製造方法、アルミニウム構造体組立体、アルミニウム配線基板、半導体装置、お… | 凸版印刷株式会社                              |
| 15 無電解めっきの前処理皮膜形成用組成物  | 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所                    | 44 | 配線基板およびその製造方法                                     | 凸版印刷株式会社                              |
| 16 高分子材料のめっき物  | アキレス株式会社                              | 45 | めっき触媒および方法  | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー |
| 17 触媒の吸着処理方法および吸着処理装置  | 学校法人 関西大学                             | 46 | めっき処理材の製造方法およびめっき処理材                              | トヨタ自動車株式会社                            |
| 18 金属めっき皮膜を有するポリオレフィン系樹脂基材の製造方法  | 国立大学法人福井大学                            | 47 | プリント配線板用基材およびプリント配線板用基材の製造方法                      | 住友電気工業株式会社                            |
| 19 貴金属被膜およびその製造方法  | 日本碍子株式会社                              | 48 | 無電解Niめっき被膜を有する構造物、半導体ウエハ及びその製造方法                  | J X日鉱日石金属株式会社                         |
| 20 膜型圧電/電歪素子およびその製造方法  | 日本碍子株式会社                              | 49 | 金属めっき方法及びそれを用いて作製された金属めっき物                        | グリーンケム株式会社                            |
| 21 半導体チップ搭載用基板及びその製造方法   | 日立化成株式会社                              | 50 | 構造体、及びそれを含む電子部品、プリント配線板                           | TDK株式会社                               |
| 22 還元型無電解銀めっき液及び還元型無電解銀めっき方法   | 上村工業株式会社                              | 51 | 積層体、及び積層体の製造方法                                    | 学校法人関東学院                              |
| 23 半導体チップ搭載用基板及びその製造方法   | 日立化成株式会社                              | 52 | 無電解めっき方法、及びこの方法によって形成した無電解めっき層を有する構造体             | 独立行政法人産業技術総合研究所                       |
| 24 電磁波透過用金属被膜、電磁波透過用金属被膜の製造方法及び車載用レーダ装置用のレドーム                            | 三恵技研工業株式会社                            | 53 | 半導体装置およびその半導体装置の製造方法                              | 三菱電機株式会社                              |
| 25 プリント回路基板の製造方法   | サムソン エレクトロ・メカニクス カンパニーLtd.            | 54 | 金属被覆繊維  | アキレス株式会社                              |
| 26 燃料電池用集電板及びその製造方法  | 日本軽金属株式会社                             | 55 | 導電性材料及びその製造方法                                     | 国立大学法人信州大学                            |
| 27 無電解パラジウムめっき液  | サムソン エレクトロ・メカニクス カンパニーLtd.            | 56 | 金属材料のめっき方法および固体高分子電解質膜・触媒金属複合電極                   | 三菱電機株式会社                              |
| 28 基板及びその製造方法  | サムソン エレクトロ・メカニクス カンパニーLtd.            | 57 | 金めっき液用亜硫酸金塩水溶液                                    | 日本高純度化学株式会社                           |
| 29 摺動部品及びその製造方法  | 日本メッキ工業株式会社                           | 58 | メッキ方法およびメッキ配線                                     | 株式会社電子技研                              |

以下12点省略